PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-083012

(43)Date of publication of application: 09.04.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/13

G02F 1/1333 G02F 1/1339

(21)Application number: 01-220733

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

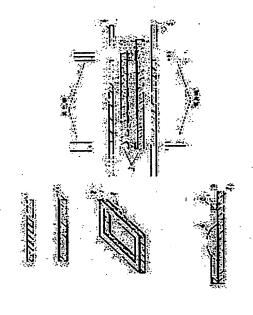
28.08.1989

(72)Inventor: KASHIWAGI TAKAFUMI

(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL PANEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a sealing material from being broken through by a liquid crystal before curing and to completely cure the sealing material in a short period of time by providing an adhesive agent consisting of a UV curing type resin or hot melt type resin on both surfaces of a frame-shaped film. CONSTITUTION: A plastic film 1 having a frame shape is disposed on the surface of a film substrate 3 subjected to an orientation treatment and a required amt. of the liquid crystal 4 is dropped into the frame. A film formed with transparent electrode patterns is used for the film substrate 3. After the other film substrate 3 is superposed thereon, a mask 6 to prevent the fall of UV rays onto the liquid crystal is provided. The adhesive agent is then irradiated with UV rays from both the front and rear surfaces and is thereby cured. The leaking out of the liquid crystal by breaking through the sealing material is obviated in this way even when a deviation arises in the flow of the liquid crystal and the liquid crystal comes into partial contact with the seal at the time of sticking of the substrates to each other after dropping of the liquid crystal. The adhesive agent layer is merely necessitated to be provided extremely thinly on the surface of the frame-shaped film and, therefore, the time for the irradiation with UV rays is drastically shortened.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-83012

@Int.Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)4月9日

G 02 F

1/13 1/1333 1/1339 1 0 1 5 0 0 5 0 5 8806-2H 7610-2H 7610-2H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

49発明の名称

液晶パネルの製造方法

②特 頭 平1-220733

20出 願 平1(1989)8月28日

@発明者

柏木隆文

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

勿出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 栗野 重孝

外1名

明 細 1

1、発明の名称

液晶パネルの製造方法

- 2、特許請求の範囲
- (2) 紫外線硬化型接着剤の代わりにホットメルト型接着剤を用い、両フィルム基板を重ね合わせて加圧および加熱し両フィルム基板を接着することを特徴とする新水項1記載の液晶パネルの製造方法。
- (3) プラスチックフィルムの両面に接着剤を塗布:

したものセシール材として用いて1枚のフィルム基板に多数個の液晶パネルを作成した後、前記シール材を横断して切断し、個片の液晶パネルを得ることを特徴とする液晶パネルの製造方法。

3、発明の詳細な説明

宣業上の利用分野

本発明は文字や映像の表示装置や光学的シャッターに用いる液晶パネルに関し、特に高信取性のフィルムを用いた基板液晶パネルの製造方法に関するものである。

従来の技術

第4図にフィルム基板液晶パネルの断面図を示す。

電極パターン5が形成された2枚のフィルム基板3をシール材11を用いて接合し、その間隙に液晶4を封入している。電極表面には液晶分子を配向させるための配向処理が遊され、またシール材11中および液晶4中にはスペーサ材12か分散されている。シール材11は熱硬化型樹脂ある

واد

いは紫外線硬化型樹脂中にスペーサ材12として一定粒径の樹脂または無機物の球状ビーズあるいはガラスファイバーを混合したものをフィルム基板3上にスクリーン印刷法で形成したものである。

液晶 4 を基板間隙に封入する方法の一つとしては、シール材 1 1 に閉口部を設けず完全に液晶封入領域を囲む枠形に形成し、必要量の液晶 4 を枠形内部に滴下した後真空中で 2 枚のフィルム基板3を接合し液晶パネルを得る方法がある。

発明が解決しようとする課題

ところで、シール材11に関口部を設けず、必要量の液晶4を滴下した後真空中で2枚のフィルム基板を接合し、所定量の液晶4が封入された液晶パネルを得るものであり、フィルム基板3の接合と同時に液晶の注入が終了するため、工程を誘が短い特長がある。ところがフィルム基板3を誘い、特に液晶4が速く、特に液晶4が速く流れた部分では液晶4がシール樹脂11を突き破る現象が発生する。フィ

断線である。 その結果、 同図 b に示すようにフィルム 基板 3 が シール材 1 1 より外側に突き出たひさし部分が形成され、 ごみや水液の付着による信頼性の低下やハンドリング中の引っ掛けによるシール外れが発生し易いという問題がある。

本発明は上記問題点を解決するために、シール 材を硬化する前に液晶にシール材が突き破られる ことがなく、短時間に完全にシール材が硬化する 液晶パネルを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本発明の液晶パネルの製造方法は、前記では、前記であるために、所定の関連を選集を選集を選集を選集を選集を受けている。
一般の関連を選集を受けている。
一般の関連を受けている。
一般の内では、対象を関している。
一般の内では、対象を関している。
一般の内では、対象を関している。
一般の内では、対象を関している。
一般の内では、対象を関している。
一般の内では、対象を関している。
一般の内では、対象を関している。

また、1枚の基板に多数圏の液晶パネルを作成した後切断し、個片のパネルを得ることが一般に行われるが、シール材11中にはガラスファイパーなどのスペーサと印刷通性を向上するためのシリカ等の無機フィラーが充填されているため、パネル切断の際に第5図に示すように打抜き金型や押し切り刃の磨耗を防ぐためにシール材の外側を切断する必要がある。間図ュにおいて13は引き出し電極を露出するための穴であり、12が切

作用

さらに1枚のフィルム基板に多数個の液品パネルを作成した後切断し、個片のパネルを得る場合には、シール材中のスペーサーや無機フィラーを含まないためシールを横断して切断することができ、シール材から基板が突き出たひさし部をなくすことができる。

赛施例

以下本発明の液晶パネルの製造方法の一実施例を図面を用いて説明する。

実施例1

第1図a~eは液晶パネル製造工程の説明図で ある。第1図aにおける1はブラスチックフィル ムで、厚みは必要な液晶層厚とほぼ同じであり本 実施 例では 6 . 5 μ m の P E S (ポリエーテルサ ルフォン)フィルムを用いる。第1図bは同図a のプラスチックフィルム1に紫外線硬化型接着剤 2を約14m厚にロールコータを用いて塗布した ものであり、同図では接着剤を塗布後液晶封入領 域を囲む枠形状にプラスチックフィルム1を切断 したものである。次に第1図はに示すように枠形 状のプラスチックフィルム1を配向処理を施した フィルム基板3麦面に配置し、枠内部に必要量の 液晶4を滴下する。フィルム基板3は透明電極バ ターンを形成した100μm厚のPESフィルム を用いる。次に第1図eに示すように他方のフィ ルム基板3を重ね合わせた後液晶に紫外線が当た るのを防ぐマスク6を設け、上下両面より紫外線

入領域を囲む枠形状にフィルムを切断したもので ある。次に第2図dに示すように抑形状フィルム を配向処理を施したフィルム基板3表面に配置 し、枠内部に必要量の液晶4を滴下する。フィル ム基板 3 は透明 電極パターンを形成した 1 0 0 μ m 厚のPESフィルムを用いる。次に第2図eに示 すように他方のフィルム基板3を重ね合わせた 後、上面より加熱ツール8を約3秒圧接し、接着 剤層を約180℃に加熱し両基板を融管する。他 方のフィルム基板3を重ね合わせ熱圧着する工程 は液晶パネル内部に気泡を残さないために真空中 で行う必要がある。加熱ツール8はブラスやアル ミなどの金属プロックの下面を同図 e に示すよう に枠形に一致する形状に加工し、ヒーターを組み 込んだものである。フィルム基板3がガラスの場 合は熱ひずみにより破損する場合があるが、PES フィルムの場合は短時間であれば200℃程度に 耐えるため基板の損傷はなく、しかもフィルム厚 が100μmしかないため熱伝導が良くごく短時 間の加熱で接着することが可能である。なお、基

実施例 2

第2図a~εは液晶パネル製造工程を順を追って説明する図である。第2図aにおける1はブラスチックフィルムで、厚みは必要な液晶層厚とほぼ同じであり本実施例では 6.5 μmの PESフィルムを用いる。第2図bは同図aのフィルムに軟化点が約140℃のポリエステル采ホットメルト型接着剤7を約1μm厚にロールコータを用いて塗布したものであり、同図cは塗布後液晶封

板材料はPESに限らずホットメルト型接着剤の 軟化点以上の耐熱性があれば使用することができ る。同一基板上に多数個の液晶パネルを作成した 場合は、実施例1と同様にして個片のパネルに分 けることができる。

特開平3-83012 (4)

時間で基板を接合することが可能で、さらに工程 時間を短縮できる。

発明の効果

本発明によれば、シール材は枠形状フィルムの両面に紫外線硬化型掛脂あるいはホットメルト型樹脂からなる接着剤を設けたものであり、液晶滴下後の基板張り合わせ時に液晶の流動に偏りが生じ部分的に液晶がシールに接する場合においても、液晶がシールを突破し調れ出ることがない。

晶パネルを示す断面図である。

1 … … プラスチックフィルム、2 … … 紫外線硬化型接着剤、3 … … フィルム基板、4 … … 液晶、5 … … 電極、7 … … ホットメルト型接着剤、8 … … 加熱ツール。

代理人の氏名 弁理士 栗野里孝 ほか1名

必要はなく、枠形状フィルム表面にごく前く設けるだけで十分であるため、紫外線照射時間は大幅に短縮できる。また、ホットメルト型接着剤の場合は加熱ツールを短時間圧接するだけで接着完了するために工程時間を短縮できる。

さらに、 1 枚のフィルム基板に多数個の液晶パネルを作成した後切断し、 個片のパネルを得る場合には、 シール材中にスペーサーや無機フィラーを含まないため シールを機断して切断することができ、 シール材から 基板が突き出たひさし部をなくすことができる。

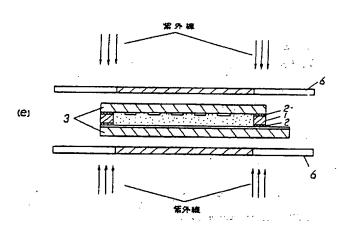
4、図面の簡単な説明

第1図a~eは本発明の一実施例の工程説明図、第2図a~eは本発明の他の実施例の工程説明明図、第3図a.bは1枚の基板に多数個の心を設めている切断工程の液晶パネルを示す断面図、第4図は従来の製造方法による液晶パネルを示す断面図、第4図は従来の製造方法による液晶パネルを示す断面図、第5図は1枚の基板に多数個の液晶パネルを作成した。

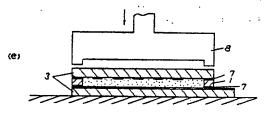
(a) 2 ... 2

(d) A 2 5

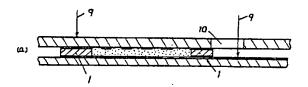
第 1 図

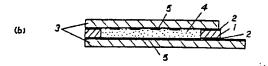


第 2 図

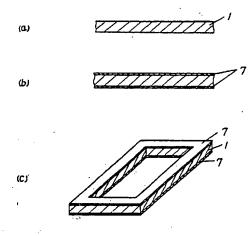


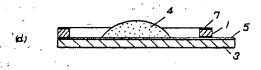
第 3 図



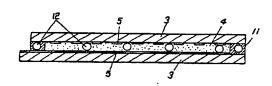


第 2 図





第 4 図



8 5 69

